

# 中信建投证券股份有限公司关于 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：北京燕东微电子股份有限公司
保荐代表人姓名：张林	联系方式：010-85156450 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层
保荐代表人姓名：侯顺	联系方式：010-65608236 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕2575 号文”批准，北京燕东微电子股份有限公司（简称“公司”或“燕东微”），同意燕东微首次公开发行股票注册申请。本次公司发行新股的发行价为 21.98 元/股，募集资金总额为 395,344.63 万元，扣除发行费用 19,693.29 万元后，实际募集资金净额为 375,651.34 万元。本次公开发行股票于 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

## 一、持续督导工作情况

	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构与燕东微签订持续督导相关协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解燕东微经营情况，对

	工作内容	持续督导情况
		燕东微开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2023年燕东微在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。	2023年燕东微在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	在持续督导期间，保荐机构督导燕东微及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促燕东微依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对燕东微内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，燕东微的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促燕东微严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应	保荐机构对燕东微的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况

	工作内容	持续督导情况
	及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2023年燕东微及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2023年燕东微及其控股股东不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2023年，经保荐机构核查，燕东微不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	2023年，燕东微未发生相关情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大	2023年，燕东微不存在需要专项现场检查的情形

	工作内容	持续督导情况
	违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	2023年，燕东微不存在未履行承诺的情况

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现燕东微存在重大问题。

## 三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

### （一）核心竞争力风险

#### 1、产品研发与技术迭代风险

半导体行业属于技术密集型行业，具有工艺技术迭代快、资金投入大、研发周期长等特点，分立器件及模拟集成电路业务新的应用场景不断涌现；晶圆制造业务代工客户需求更新迭代非常迅速，且产品品种较多；特种集成电路及器件技术呈现高传输速率、小型化、专用化、模块化、系统化的发展趋势；公司需要根据市场需求不断优化产品设计，升级产品制造工艺，提升产品性能和质量管控水平，及时跟进技术发展趋势。如果公司的技术与相关工艺未能进行推陈出新，跟上竞争对手新技术、新工艺的持续升级，可能导致公司产品被替代，对公司的持续竞争力产生不利影响。

#### 2、研发不及预期风险

公司产品及技术主要依靠自主研发，但由于半导体行业产品、技术研发往往有着难度高、周期长、投入多、不确定性高等特点，若公司现有的研发不及预期，既会造成前期的投入无法转换成产品，从而浪费大量的人力物力，又会因没有新技术使用而使得产品落后于竞争对手，从而影响经营效益；即使公司研发成功，也可能面临新技术的涌现，使得已经研发的技术不再满足市场需求，从而影响公

司的可持续发展。

### **3、关键技术人才流失的风险**

半导体行业具有技术密集型的特点，对技术人才的专业性及经验要求较高。随着半导体行业快速发展，人才需求与日俱增，人才竞争持续加剧，诸多半导体公司通过授予技术人才股票期权、设置关键岗位为技术人才提供施展平台等方式吸引人才，若公司不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件，存在关键技术人员流失的风险。

## **(二) 经营风险**

### **1、行业周期性及公司经营业绩波动风险**

半导体行业具有较强的周期性特征。公司分立器件及模拟集成电路业务、晶圆制造业务、封装测试业务的终端应用以消费电子领域为主。如果消费电子等公司所处下游行业整体出现较大周期性波动，公司未能及时判断下游需求变化，或者受市场竞争格局变化、公司产能利用率走低、研发不及预期等因素影响，导致公司出现产品售价下降、销售量降低等不利情形，公司收入持续增长存在不确定性风险。

### **2、客户集中度较高的风险**

公司客户相对集中，如果未来公司主要客户经营状况发生重大不利变化、采购需求下降或调整采购策略，可能导致公司订单下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

### **3、主要原材料供应商集中度较高及原材料供应风险**

公司生产依赖于多种原材料，原材料的及时供应是保证公司稳定生产的必要条件。如果未来公司主要供应商因产能紧张而大幅提升售价、推迟供货，或者由于国际政治及其他不可抗力等因素，停止向公司供货，将导致公司短期内材料供应紧张或成本上升，从而对公司盈利能力产生不利影响。

### **4、核心技术泄密风险**

新产品、新工艺持续开发能力是集成电路企业的核心竞争力，经过三十余年

的发展与积累，公司形成了一定数量的发明专利和非专利技术，这些技术成为公司在市场竞争中取得成功的重要依托。如果公司核心技术被竞争对手窃取或抄袭，则可能产生核心技术泄密风险，导致公司产品与方案业务及制造与服务业务的市场竞争力下降。

### **（三）财务风险**

#### **1、信用风险**

公司主要客户均为长期合作、信用水平较高、应收账款回款良好的企业，且公司对应收账款余额进行持续监控，但如果市场环境发生不利变化、部分客户出现经营风险而不能按时回款，公司可能存在因坏账损失增加导致经营业绩下滑的风险。

#### **2、存货风险**

随着公司经营规模和经营业绩的不断扩大，期末存货余额可能会随之提高，如果公司存货管理不够科学，占用公司的营运资金，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

#### **3、利率风险**

公司负债率较低，由于市场利率变动的风险与公司借款相关，所以利率风险对公司影响较小。

#### **4、流动性风险**

为了满足公司日常经营需要，公司现金及现金等价物充足，并对其进行实时监控，因此公司所承担的流动风险较低，对公司的经营和财务报表不构成重大影响。

### **（四）行业风险**

#### **1、行业竞争风险**

在 market 需求的不断扩大、产业向中国大陆转移及国家大力支持的背景下，半导体产业面临着良好的行业发展机遇。现有市场参与者扩大产能及新投资者的进入，将可能使市场竞争加剧。如果公司不能把握市场行业发展规律、持续研发创

新并提升生产管理效率，不断优化产品设计，升级产品制造工艺，可能导致公司跟不上竞争对手新技术、新工艺的持续升级，产品失去竞争力，对公司的持续盈利能力产生不利影响。

## **2、产业政策变化风险**

半导体产业是我国的战略性产业，近年来获得了国家一系列政策的支持。在产业政策支持和国民经济发展的推动下，我国半导体行业整体的设计能力、生产工艺、自主创新能力有了较大的提升。如果未来国家相关产业政策支持力度减弱，可能导致下游市场需求下降、政府补助和税收优惠减少等不利情形，公司的持续盈利能力及成长性可能受到不利影响。

## **（五）宏观环境风险**

### **1、宏观经济波动风险**

公司身处半导体行业，半导体行业与宏观经济和政治环境密切相关，受到全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，集成电路行业的市场需求也将随之受到影响；另外下游市场需求的波动和低迷亦会导致集成电路产品的需求下降，或由于半导体行业出现投资过热、重复建设的情况进而导致产能供应在景气度较低时超过市场需求，进而影响集成电路晶圆代工企业的盈利能力；将可能对公司的经营业绩造成一定的影响。

### **2、汇率波动的风险**

受政治、经济形势的变化以及中国外汇政策等因素的影响，人民币与美元及其他货币的汇率存在波动，公司难以预测市场、金融政策等因素未来可能对人民币与美元汇率产生的影响，可能对本公司的流动性和现金流造成不利影响。

### **3、国际贸易摩擦风险**

由于国际贸易政策存在一定的不确定性。如果全球贸易摩擦加剧，境外客户可能会减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况，则公司的经营可能会受到不利影响。

## 四、重大违规事项

在本持续督导期间，燕东微不存在重大违规事项。

## 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	2,126,903,653.81	2,175,224,334.82	-2.22
归属于上市公司股东的净利润	452,292,466.72	462,125,789.66	-2.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,503,381.80	364,522,471.61	-20.03
经营活动产生的现金流量净额	402,768,425.36	796,394,617.50	-49.43
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	14,859,119,796.56	14,348,604,152.99	3.56
总资产	18,484,430,578.71	17,824,653,931.58	3.70

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.38	0.45	-15.56
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.45	-15.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.36	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	3.10	4.46	减少 1.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.00	3.52	减少 1.52 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	13.92	7.96	增加 5.96 个百分点

1.营业收入同比下降 2.22%，主要系市场需求发生变化，部分消费类产品价格下降及需求下滑所致；

2.归属于上市公司股东的净利润同比下降 2.13%，主要系市场需求发生变化，部分消费类产品价格下降及需求下滑所致；

3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 20.03%，主要系市场需求发生变化，部分消费类产品价格下降及需求下滑所致；

4.经营活动产生的现金流量净额同比下降 49.43%，主要系本期销售回款有所下降以及收到进项税留抵退税较同期下降所致；



5.归属于上市公司股东的净资产和总资产较期初分别增长 3.56%、3.70%，主要系本期留存收益增加所致；

6.基本每股收益以及稀释每股收益较上年同期下降 15.56%，主要系本期归属于母公司所有者的净利润同比下降，本期加权平均股数同比增加所致；

7.扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 33.33%，主要系本期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润同比下降，本期加权平均股数同比增加所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### （一）集设计、制造和封测于一体的全产业链运营能力

公司以“成为卓越的集成电路制造和系统方案提供商”为愿景，初步完成“6+8+12”英寸晶圆产线布局，坚持 More than Moore 和特色工艺融合发展方向，走 IDM+Foundry 的发展路线。公司经过三十余年的发展与积累，形成了具有自身特色的集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的 IDM 运营模式，同时，公司注重特色工艺开发，可灵活快速支持企业持续完善产品性能、拓展产品功能，提升产品竞争力。此外，公司长期以来形成的 IDM 运营模式，有助于增强企业抵御市场波动的能力及保持生产的稳定运营。

### （二）特种集成电路及器件产品持续丰富，客户长期稳定

公司持续丰富特种集成电路及器件，其中单片集成电路产品新增了低压（5V）、中压（±5V/12V）、高压（±15V）模拟开关系列新产品；混合集成电路产品新增了为用户定制开发的专用预处理模块系列；功率器件拓展了硅基射频 LDMOS 和 VDMOS 的部分产品；光电器件完成了光电耦合器系列产品中的发光芯片的国产化研制，在特种集成电路及器件工艺技术方面，研发的高可靠高压 CMOS SOI 工艺，具有天然免疫闩锁、抗过电应力能力强，可靠性高等特点；混合集成电路用的高精密金属膜电阻制备的薄膜工艺目前可达 10PPM 精度水平。基于持续丰富的产品系列以及不断提升的工艺技术能力，特种产品应用市场稳定。

### （三）制造与服务能力大幅提升，核心竞争力显著增强

在工艺平台建设方面，基于 6 英寸、8 英寸、12 英寸晶圆生产线，聚焦功率半导体、光电子、传感器、ASIC 四大产品方向，实现了以下工艺平台的建设及拓展：

（1）12 英寸晶圆生产线高密度功率器件完成了客户的可靠性认证，良率达

到 98.5%以上；

(2) 8 英寸晶圆生产线 IGBT 和 FRD 等工艺平台产品通过了国内新能源汽车头部企业的可靠性认证并实现批量供货；标准 CMOS 工业用显示驱动电路通过客户验证；HV CMOS 低边 MOSFET 栅极驱动完成样品研制；基于超高压 600V BCD 工艺平台基础上实现 13 款产品规模化量产；

(3) 1200V SiC SBD 产品通过客户样品验证目前产品良率达到 95%以上；1200V SiC MOS 器件产品完成了样品试制并通过了可靠性试验；

(4) SiN 硅光工艺平台实现关键突破，完成了一款激光雷达和一款光通信产品的量产，产品良率达 95%以上。

#### **(四) 完善的质量管理体系和稳定的客户资源**

公司高度重视产品从研发到交付各环节的质量控制，公司已通过 ISO14001、ISO45001、ISO9001、IATF16949 等体系认证，逐步建立起了完整的质量管理体系，并参与多项国家电子行业标准的制定。公司拥有完备的可靠性实验室和产品异常解析实验装置，对产品进行可靠性认证及产品的异常失效分析，以期能更好地保障产品质量。公司始终秉承质量第一、客户至上的经营理念，在多个细分领域推出了品质优异、性能稳定的系列化产品，在满足了客户需求，获得了市场认可的同时，积累了大量稳固的客户资源。

## **七、研发支出变化及研发进展**

### **(一) 报告期内获得的研发成果**

1、12 英寸晶圆生产线高密度功率器件完成了客户的可靠性认证，良率达到 98.5%以上；

2、8 英寸晶圆生产线 IGBT 和 FRD 等工艺平台产品通过了国内新能源汽车头部企业的可靠性认证并实现批量供货；

3、基于超高压 600V BCD 工艺平台基础上实现 13 款产品规模化量产；

4、8 英寸标准 CMOS 工业用显示驱动电路通过客户验证；

5、8英寸HV CMOS 低边MOSFET 栅极驱动完成样品研制；

6、1200V SiC SBD 产品通过客户样品验证目前产品良率达到95%以上；  
1200V SiC MOS 器件产品完成了样品试制并通过了可靠性试验；

7、SiN 硅光工艺平台实现关键突破，传输损耗<0.1dB/cm，并实现一款激光雷达和一款光通信产品的量产，产品良率达95%以上；正在导入多款可应用于O-Band、C-Band 不同波段下的通信类产品；SOI 硅光工艺平台完成了关键器件工艺开发。

## （二）报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	22	13	148	77
实用新型专利	33	31	302	296
外观设计专利	0	0	0	5
软件著作权	3	2	19	18
集成电路布图	12	12	43	46
商标	0	0	21	11
合计	70	58	533	453

## （三）研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	295,971,254.94	173,106,995.67	70.98
资本化研发投入			
研发投入合计	295,971,254.94	173,106,995.67	70.98
研发投入总额占营业收入比例（%）	13.92	7.96	增加5.96个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单元：元

项目	金额
募集资金总额	3,953,446,261.66
减：发行费用总额	196,932,884.69
募集资金净额	3,756,513,376.97
加：自有资金账户支付的发行费用	14,925,170.00
2022 年 12 月 13 日收到的募集资金净额	3,771,438,546.97
加：2022 年利息收入（减手续费）	1,591,905.81
加：2023 年度利息收入（减手续费）	32,765,966.06
减：截至 2023 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额	2,959,879,926.84
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金账户余额	830,991,322.00
其中：募集资金专项账户期末余额	46,511,322.00
用于现金管理尚未到期金额	784,480,000.00

公司 2023 年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

名称/姓名	类别	年初直接持股数	年末直接持股数
北京电控	控股股东、实际控制人	420,573,126	420,573,126
张劲松	董事长	0	0
朱保成	副董事长	0	0
淮永进	董事、总经理	0	0
旷炎军	董事	0	0
郑浩	董事	0	0

龚巍巍	董事	0	0
范晓宁	董事	0	0
顾振华	董事	0	0
任天令	独立董事	0	0
韩郑生	独立董事	0	0
李轩	独立董事	0	0
周华	独立董事	0	0
王爱清	监事会主席	0	0
彭雪妮	监事	0	0
元巍	监事	0	0
李孟佳	监事	0	0
侯少茹	监事	0	0
霍凤祥	副总经理、董事会秘书	0	0
李剑锋	副总经理	0	0
唐晓琦	副总经理	0	0
陈兆震	副总经理	0	0
滕彦斌	财务总监	0	0

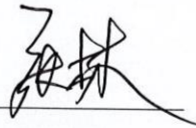
截至 2023 年 12 月 31 日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的不存在质押、冻结及减持情况。

## 十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



张 林



侯 顺

中信建投证券股份有限公司



2024 年 5 月 30 日